

Bild 1  
 Härteverlauf einer AlCu-Legierung beim Walzen um 10%  
 und Auslagern bei 150°C nach verschiedener Vorbehandlung  
 nach G. Wassermann (5)

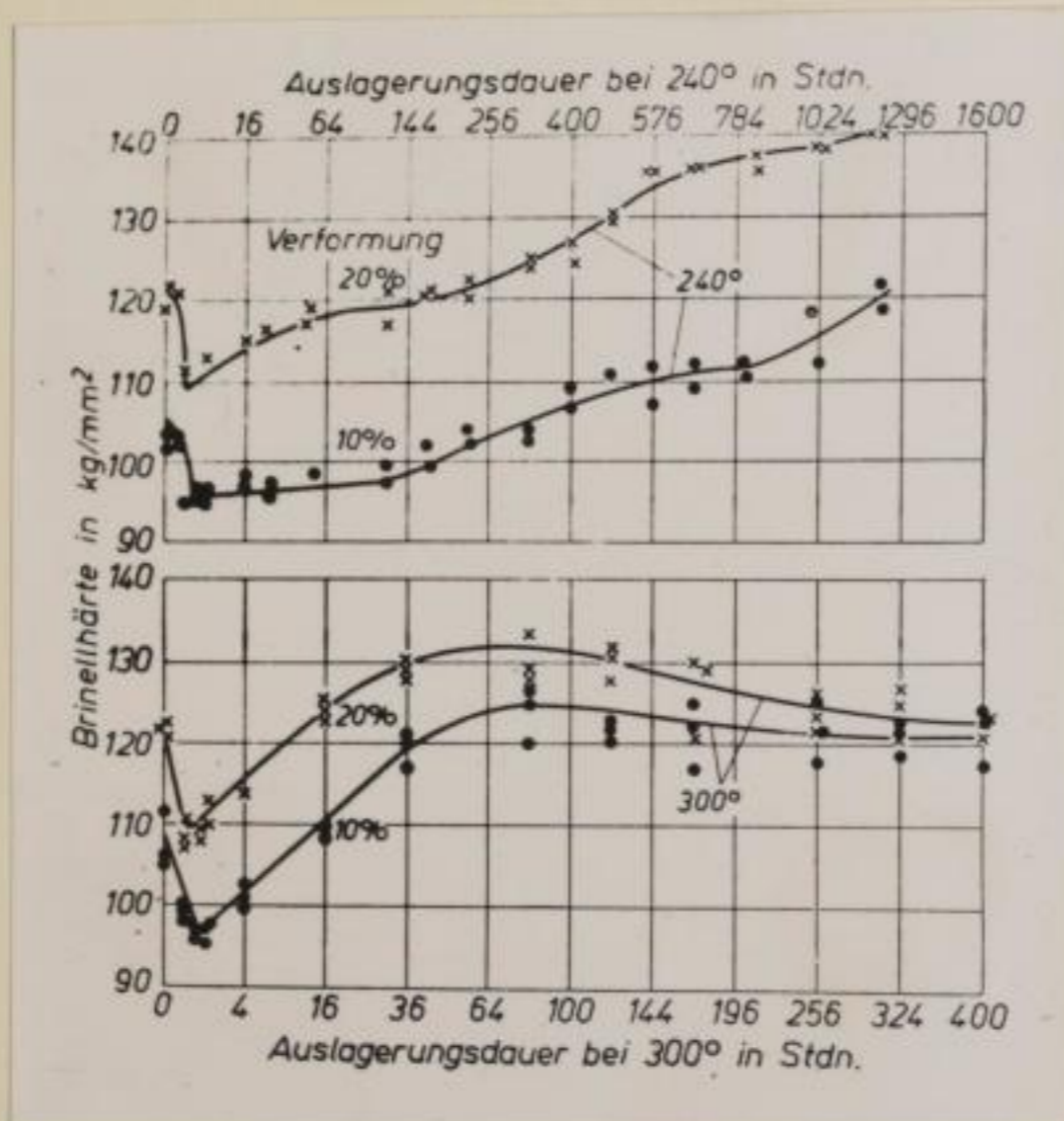


Bild 2  
 Härteverlauf einer Cu-Legierung mit 4,3% Cd  
 nach Homogenisierung bei 650°C und Abschrecken  
 an Luft beim Walzen um 10% und 20% und Auslagern  
 bei 240°C und 300°C  
 nach G. Schlösser und G. Wassermann (7)